

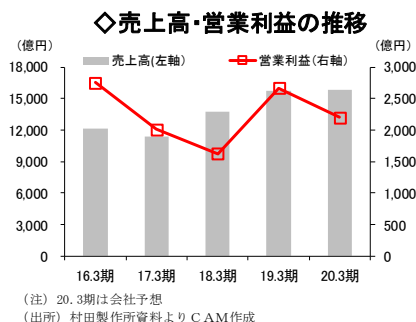
企業ニュース 村田製作所

(東証1部：6981) <http://www.murata.com/>

作成者：村上大志

総合電子部品メーカー大手

1944年創業。電気の蓄積や流れを整える働きをし、電子回路には欠かせない積層セラミックコンデンサ(以下MLCC)が通信、カーエレクトロニクス分野で世界シェア約40%の総合電子部品メーカー大手。MLCC以外では、無線信号の中から必要な信号だけを取り出す表面波フィルタや、無線通信によるインターネットへのアクセスを可能にするコネクティブイティモジュールでも高いシェアを持つ。材料から製品までの一貫生産体制を構築し、セラミック材料などの電子部品材料をはじめ、高周波や回路設計、薄膜・微細加工技術などのプロセス技術、製品の分析・評価等の基盤技術を独自に開発・蓄積していることが強み。目標とする経営指標は、売上高年成長率5-10%及び新製品売上高比率40%、営業利益率20%以上(為替水準1米ドル=115円)。



今期はリスクを織り込んだ保守的な計画

19.3期の連結業績は受注高が1兆5,485億円、前期比6%増。売上高が1兆5,750億円、同15%増、営業利益が2,668億円、同63%増。主力のMLCCはカーエレクトロニクスやスマートフォン(以下スマホ)、PC向けなど幅広い用途で増加した。旧型設備の減損が発生したが、操業度の上昇や原価低減への取り組みが奏功したことに加え、MLCCの価格是正が進み大幅な増益となった。受注残高は2,634億円、同5%減。中国でのスマホの生産調整等の影響を受けた。

20.3期の通期会社計画は売上高が1兆5,800億円、前期比横ばい、営業利益が2,200億円、同18%減。スマホや車載向けの電子部品の在庫調整が想定以上に長引いており、操業度の低下や減価償却費の増加を見込み減益の計画。受注トレンドは4月から若干上向いている模様で、夏場に向け回復が期待される。1月からのMLCCの値上げは3月でほぼ達成しており、業績への貢献が見込まれる。5Gの本格的な立ち上がりもあり、当社の高性能電子部品の需要増加が期待できよう。

[株価動向・投資判断]

減益計画の発表で株価にはネガティブサプライズとなったが、同計画はハイエンドスマホの出荷台数を慎重にみるなど、リスクを織り込んだ保守的な計画だと考える。

<6981 村田製 業績:米国基準>

[今期予想の配当金は発行会社予想]

	売上高	営業利益	税引前利益	当期利益	1株利益	1株配当
	百万円 (伸び率)	百万円 (伸び率)	百万円 (伸び率)	百万円 (伸び率)	円	円
18.3	1,371,842 (21)	163,254 (▲ 19)	167,801 (▲ 16)	146,086 (▲ 6)	685.9	260.00
19.3	1,575,026 (15)	266,807 (63)	267,316 (59)	206,930 (42)	970.4	280.00
20.3 予	1,580,000 (0)	220,000 (▲ 18)	222,000 (▲ 17)	170,000 (▲ 18)	265.7	94.00

(注)19年4月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施。



[主要株価指標]	(売買単位: 100株)
株価 (2019/4/26)	5,960 円
年初来高値 (高値日)	6,150 円 (19/3/6)
同 安値 (安値日)	4,360 円 (19/1/4)
予想 P E R (20.3 予)	22.4 倍
1株株主資本 (PBR算出用)	2,507.1 円
P B R	2.38 倍
予想配当利回り (1株当たり配当金94.00円)	1.58 %
R O E (19.3)	13.5 %
発行済み株式数	67,581 万株